

性能特点：

- 频带：6-18GHz
- 插入损耗：1.0dB
- 插损波动： ± 0.3 dB
- 隔离度：16dB
- 输入回波损耗：10dB
- 输出回波损耗：16dB
- 芯片尺寸：2.2mm \times 1.3mm \times 0.1mm

产品简介：

HH-PD30618 是一款 GaAs MMIC 0°三路功分器芯片，该功分器芯片具有插损小、隔离度高、体积小、易集成等特点，其频率范围覆盖 6~18GHz。

电参数： ($T_A=25^\circ\text{C}$)

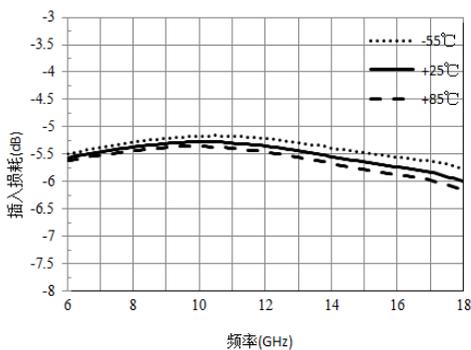
指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	6~18			GHz
插入损耗	-	1.0	1.2	dB
插损波动	-	± 0.3	-	dB
隔离度	16	20	-	dB
输入回波损耗	10	15	-	dB
输出回波损耗	16	20	-	dB

使用限制参数： (超过以下任何一项最大限额都有可能造成永久损坏)

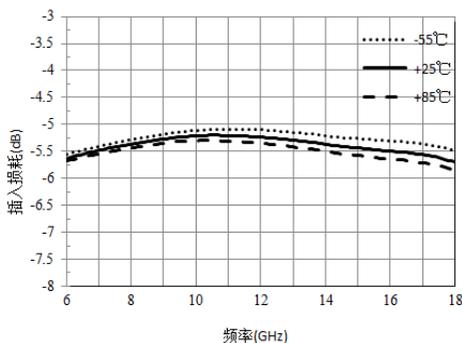
输入功率	+33dBm
存储温度	-65°C~+150°C
使用温度	-55°C~+85°C

典型曲线：

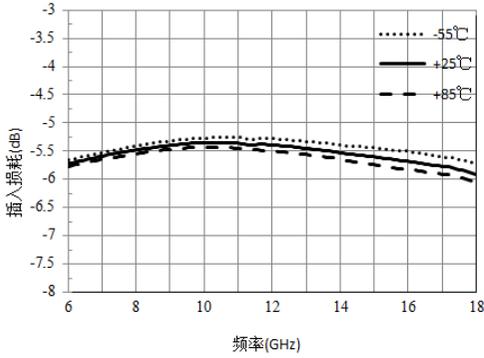
2 端口插入损耗



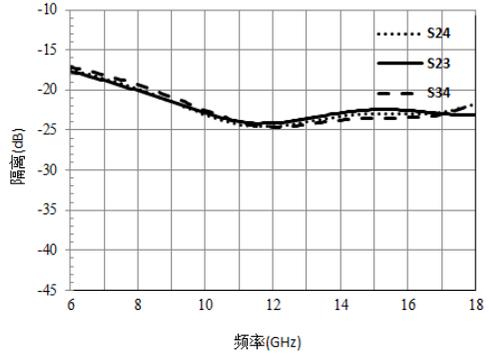
3 端口插入损耗



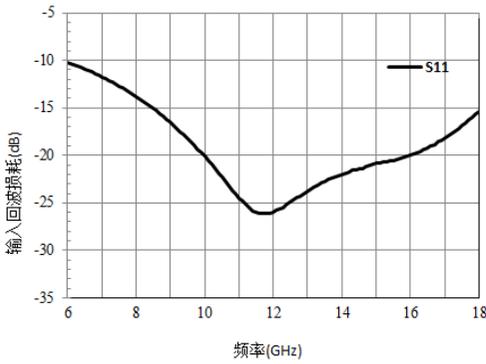
4 端口插入损耗



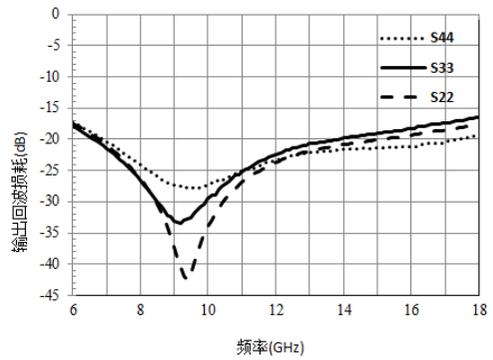
隔离度



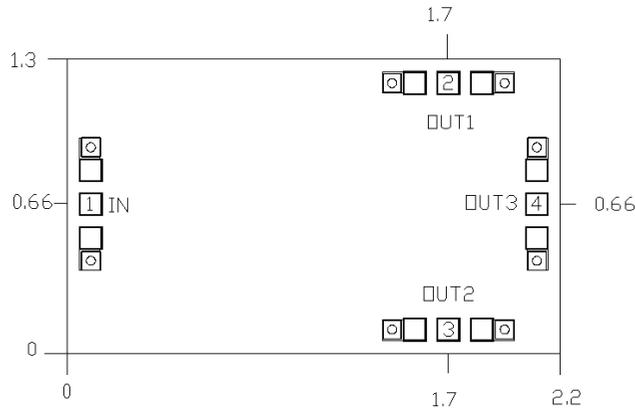
输入回波损耗



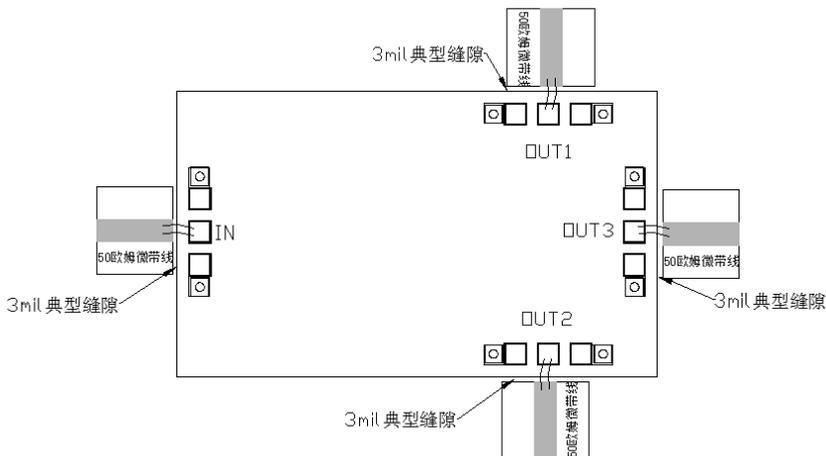
输出回波损耗



尺寸图：(单位 mm)



建议装配图：



使用说明：

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。